

集積化 MEMS の発展と展望

集積化 MEMS 技術研究会発足 10 周年記念シンポジウム

3月18日(日)
13:00～18:30

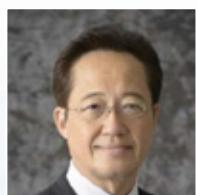
早稲田大学 西早稲田キャンパス
63号館 201(G201)

MEMS技術とLSI技術との集積化・融合は重要な課題であり、More than Mooreの解の一つとして期待され、世界的潮流として研究開発が活発化してきた。

シンポジウムでは研究会と集積化 MEMS 技術 10 年のあゆみを検証すると共に、今後の展望について情報交換する。

基調講演 (13:00～15:15)

石田 誠 豊橋技術科学大学 特別顧問、名誉教授
「集積化 MEMS 技術研究会」の発足と異分野融合研究



益 一哉 東京工業大学 教授
応物と集積化 MEMS 技術研究会



福田 和人 東日本旅客鉄道株式会社
鉄道信号技術の現在と未来：デバイスへの期待

小松崎 常夫 セコム株式会社 顧問
セコムが目指す「あんしんプラットフォーム」とデバイス技術への期待

招待講演 (15:30～18:30)

町田 克之、益 一哉 (東京工業大学)
年吉 洋 (東京大学)
田中 秀治 (東北大学)
前中 一介 (兵庫県立大学)
高尾 英邦 (香川大学)
後藤 正英 (NHK放送技術研究所)
積 知範 (オムロン株式会社)
森村 浩季 (日本電信電話株式会社)
高橋 一浩 (豊橋技術科学大学)
佐々木 実 (豊田工业大学)
鈴木 健一郎 (立命館大学)

集積化 CMOS-MEMS 技術の課題と展望
薄膜トランジスタを用いた集積化 MEMS
接合による集積化 MEMS プロセス
集積化センサ、コンボセンサ IoT センサノードへ
シリコン集積化 MEMS 技術による高解像度触覚センシング
3次元集積化技術を用いた次世代イメージセンサの研究開発
環境センサ技術の応用
LSI 回路設計の立場から見た集積化 MEMS 技術への期待
集積化 MEMS 技術によるバイオセンシング
MEMS 振動子を用いた絶縁型電圧センサ
MEMS マイクロエレクトロニクス半世紀の流れ—私の追憶—



JSAP EXPO Spring 2018

MEMS特別展示コーナー開催

2018年3月17日(土)～20日(火)
@ベルサール高田馬場 (東京都新宿区)

